公司代码:688691 公司简称:灿芯股份

灿芯半导体(上海)股份有限公司

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站时仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□适 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税)，截至2024年12月31日，公司总股本120,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,400,000.00元(含税)，占2024年度归属于母公司股东净利润的33.42%，不送红股，不以资本公积转增股本。

本事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	灿芯股份	688691	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈文萍	石晓天、戚靓卿
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区张东路1158号礼德国际2号楼7楼	中国(上海)自由贸易试验区张东路1158号礼德国际2号楼7楼
电话	021-50376585	021-50376585
传真	021-50376620	021-50376620
电子信箱	IR@fabless.com	IR@fabless.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

2.1.1公司主要业务情况

公司是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型SoC定制设计技术与半导体IP开发技术为核心的全方位技术服务体系。

依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产工作。公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市等行业。公司凭借技术积累各的优势并获取、获得了“中国半导体创新产品和技术奖”、“中国半导体市场最佳设计企业奖”、“上海市浦东新区科学技术奖”、“2021年度最具影响力IC设计企业”等多项荣誉奖项，并被权威媒体(电子工程专辑)(EETimes)评选为“全球100家最受关注的半导体初创公司”。

公司拥有基于中国大陆自主先进工艺进行芯片定制的能力，并在先进工艺实现自研高速接口IP及高性能模拟IP布局，是国内少数具有先进工艺全流程设计能力并有成功芯片定制经验的企业。除先进逻辑工艺设计能力外，公司还具备覆盖高压工艺、非挥发性存储器工艺、微电子和光电子集成工艺等先进特色工艺设计能力。

2.2.公司主要服务流程

公司基于自身的芯片设计能力、深厚的半导体IP储备与丰富的项目服务经验，为客户提供一站式芯片定制服务，包括芯片定义、IP选型及授权、架构设计、逻辑设计、物理设计、设计数据校验、流片方案设计等全流程芯片设计服务。公司在为客户提供芯片设计服务前，根据客户需求可能续约其提供芯片量产服务。

公司在长期为客户提供一站式芯片定制服务的过程中，了解并熟知国内客户的需求，并通过不断积累，公司逐步形成了一系列高性能半导体IP(You IP)，提升了公司一站式芯片定制服务的综合竞争力。

由于集成电路产业中不同行业领域客户技术侧重、产品需求各不相同，公司基于自身核心技术可在芯片设计全流程为客户提供技术支持，并根据客户需求提供相应设计服务。从服务类型来看，公司为客户提供的一站式芯片定制服务主要可分为芯片定制服务与芯片工程定制服务。

芯片全定制服务是指公司根据客户对于芯片功能、性能、功耗、面积、应用适应性等要求，借助自身全面的芯片定制能力及丰富的设计经验，根据客户需求完成芯片定义、IP及工艺选型、架构设计、前端设计和验证、数字后端设计和验证、可测性设计、模拟电路设计和版图设计、设计数据校验、流片方案设计等设计环节，并根据客户需求提供量产服务。

同时，为了更好更快地满足客户需求，帮助客户提高一次流片成功率并缩短其产品上市时间，公司自主研发形成了由高速音频DSP平台、物联网微控制器平台、高性能异构计算平台等一系列行业应用解决方案组成的系统级芯片设计平台，以“标准化方案+差异化设计”的模式快速满足客户在消费电子、工业控制、人工智能、智慧城市等众多领域的芯片定制需求。

(2)芯片工程定制服务

芯片工程定制服务主要指公司根据客户需求，完成工艺制程及半导体IP选型、设计数据校验、IP Merge、光罩数据验证、流片方案设计及工艺标准优化、系统性能评估及优化、封装及测试解决方案设计等设计服务，并根据客户需求整合第晨代工厂与封测厂等第三方厂商资源为客户提供晶圆制造、芯片封测等量产服务。

与芯片全定制服务更为侧重于产品功能及性能的设计优化和迭代，在芯片工程定制服务中，公司更为关注设计数据与物理层面工艺制程的兼容性、可由于芯片设计数据复杂、流程环节较多、生产环节的设计流程长、生产环节的设计流程长、生产环节的设计流程长